

# 学位授权点建设年度报告

## (2022年)

学位授予单位

名称：苏州大学

代码：10285



授权学科  
(类别)

名称：光学工程

代码：0803

博士

.....	1
.....	11
.....	12
.....	13
.....	16
.....	17
.....	18
.....	18
.....	20
.....	23
.....	25
.....	27
.....	28
.....	30
.....	31
.....	35
.....	35
.....	39
.....	40

10 2016

2012

B+

2011

2012

20

2017 10

3

5

28

5

3

8

19

/

34

2017 19

GB7713-87

2

2012

20

30

LED

OLED

17

14

LED

OLED

R2R

LED

100

20

18

MW

/

28

22

3D

/

16

14

82		69	84%		20
24%		44	54%	72	
88%			50		60%
	57	70%		2	45
	39				
		1			2
	1		1	1	1
		1	333	1	2
	3		1		3
	11		4		1
1					

A d e R g a c h

973	863	GF	
			100
2.8	SCI/EI	500	, 500
	200		10
	10		
			GF
	2018	2022	

2  
2  
2022  
2022  
1300  
- 2 170  
JG  
8490

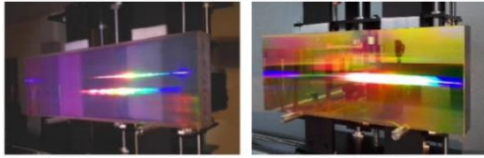
2  
400 1.7

W 8 2018

3D VIVO  
3D

II  
1





突破封锁，研制国内最大口径脉冲压缩光栅，持续应用在“神光”等国之重器上



米级口径航天光学元件加工检测等技术，在“海洋一号”、“高分七号”等在轨卫星中使用



研制国内最大、国际先进的大幅面高分辨率紫外直写光刻装备并实现出口



研制的避障相机、导航地形相机地面模拟器，用于“天问一号”探测器火星车 GNC 地面测试设备



超薄导光器件、纳米光变色转印膜、110 寸大尺寸电容触控屏和信息交互智能终端等填补国内空白



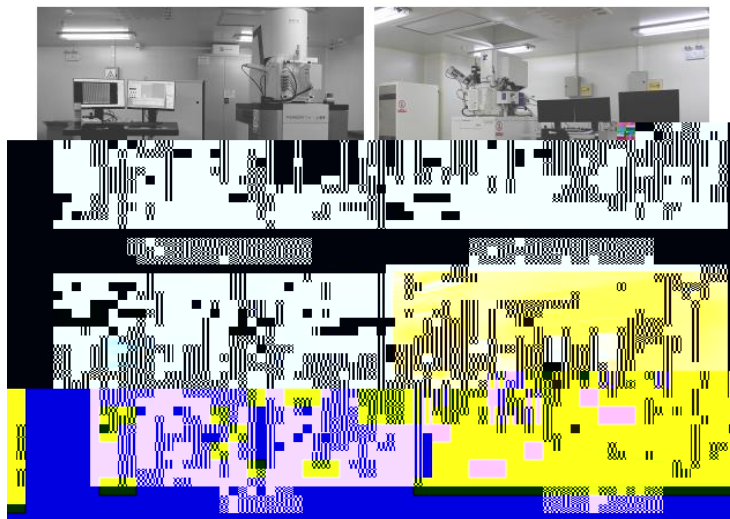
大尺寸触控屏成功应用于北京大兴国际机场


2.2

2

1.2

5000



H Sca V (610×800 )

RIE

ICP

DPSSL

3

SATISLOH

G1

T2

VFT

Ta

H b e

S6

Z g

OPTIKOS

OTF

1.8

Z g

450

4D

CODE V LIGHTTOOLS ZEMAX

CATIA

PATRAN

X

X

1

16.5

4.08

80

80

2

/

A.

OSA

B.APS

C.AIP

D.

IEEE/IEEE Electronic Library IEL

E.IEL Neuroscience

F.Electrical Science Database

G.

IOP

2003

2010

2017

GF

/

2011

2.2

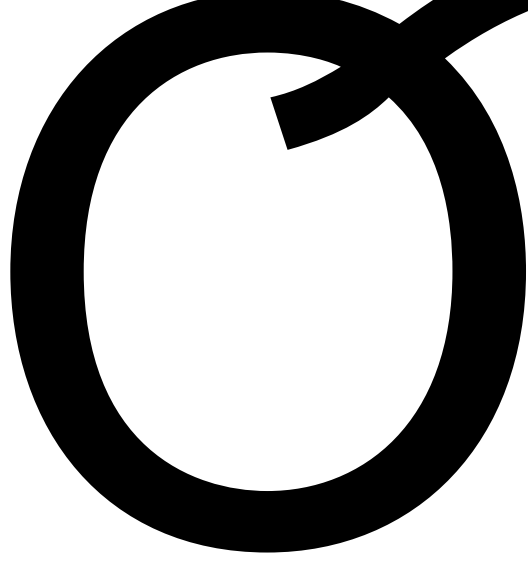
/ /

FIB EBL

ICP MBE

SEM

2022



333

40

2022

16

35

3

&


0 ԳՆՆ





2022

2022

È

10



F da e a a dA ca                      F da e a fPh c                      M c a e  
J e M e

4

3

2022

1

2023

1


--	--	--	--



2022

F da e a fPh c M c a eF da e a a d

A ca













聚焦离子束共焦刻蚀系统



电子束光刻系统



激光图形化直写设备



扫描电镜-阴极荧光系统



原子力显微镜



光荧光和拉曼谱仪

2022





**第一期**

产业前沿与职业发展主题报告

微纳光子制造：科技产业发展与前沿研究

时间：2022年4月23日  
10:00-11:30 (周六)

报告人：靳林森 研究员

“产学研”创新设计“0124157”

在微电子制造领域，微纳光子制造技术已成为支撑我国集成电路产业发展的关键技术。本报告围绕微纳光子制造技术，从产业背景、技术现状、发展趋势等方面进行了详细阐述。报告指出，微纳光子制造技术具有集成度高、功耗低、速度快等优点，在光通信、光计算、光传感等领域具有广泛的应用前景。报告还介绍了微纳光子制造技术的最新研究成果和产业化进展，并对未来技术的发展趋势进行了展望。

报告摘要：微纳光子制造技术是支撑我国集成电路产业发展的关键技术。本报告围绕微纳光子制造技术，从产业背景、技术现状、发展趋势等方面进行了详细阐述。报告指出，微纳光子制造技术具有集成度高、功耗低、速度快等优点，在光通信、光计算、光传感等领域具有广泛的应用前景。报告还介绍了微纳光子制造技术的最新研究成果和产业化进展，并对未来技术的发展趋势进行了展望。

**“走进科技，你我同行”**

2022年重点实验室线上开放日

暨产业前沿与职业发展主题报告第二期

时间：2022年6月22日，9:30-11:30

报告人：靳林森 研究员

“产学研”创新设计“0124157”

在微电子制造领域，微纳光子制造技术已成为支撑我国集成电路产业发展的关键技术。本报告围绕微纳光子制造技术，从产业背景、技术现状、发展趋势等方面进行了详细阐述。报告指出，微纳光子制造技术具有集成度高、功耗低、速度快等优点，在光通信、光计算、光传感等领域具有广泛的应用前景。报告还介绍了微纳光子制造技术的最新研究成果和产业化进展，并对未来技术的发展趋势进行了展望。

报告摘要：微纳光子制造技术是支撑我国集成电路产业发展的关键技术。本报告围绕微纳光子制造技术，从产业背景、技术现状、发展趋势等方面进行了详细阐述。报告指出，微纳光子制造技术具有集成度高、功耗低、速度快等优点，在光通信、光计算、光传感等领域具有广泛的应用前景。报告还介绍了微纳光子制造技术的最新研究成果和产业化进展，并对未来技术的发展趋势进行了展望。

**第三期**

产业前沿与职业发展主题报告第三期

光照学术与工业之路

时间：2022年6月11日  
09:30-11:30 (周六)

报告人：卢丹勇 高级工程师

腾讯会议：342-801-662

卢丹勇，博士，英特尔技术研发部高级工程师，苏州大学圣地亚哥分校访问学者，苏州大学材料科学与工程学院特聘教授，主要从事光通信器件研发、光通信器件封装、光通信器件测试等工作。在光通信器件封装、光通信器件测试、光通信器件封装测试等方面有深入研究，发表多篇学术论文，主持多项科研项目。

报告摘要：本报告围绕光通信器件封装、光通信器件测试、光通信器件封装测试等方面进行了详细阐述。报告指出，光通信器件封装、光通信器件测试、光通信器件封装测试是光通信器件研发、生产、应用的关键环节。报告还介绍了光通信器件封装、光通信器件测试、光通信器件封装测试的最新研究成果和产业化进展，并对未来技术的发展趋势进行了展望。

( )

30000/ / 20000 / /  
100%



$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & & & \\
 1 & & & & 1 & & \\
 & & 1 & & & & 1 \\
 4 & & & & & & \\
 & & & & + & & \\
 & & 1 & & & & \\
 & 1 & & & & & - \\
 & & & & & & 1
 \end{array}$$




--	--	--	--

¿			@ì 2«

1

È


100%

500

60

2

10

20

2022

2022						2
	23			1		2
		2		1		1

2022						CJ
	QB		HWYQ			
SC						23
1	1	CJ	SC	3		
			1			3
	1		1			1
			3		1	

					2022	
	1	1000				-
1			-	1		-
			6		4	2
		1		2		1

1	1
1 2022	6172.24
809.5	3271.29
1672.64	418.81

GF

8490

2022

Na e E e g

SCIE\EI\CPCI-S

116

Na e

E e g O ca Ad a ced O ca Ma e a

27

2022

1672.64

2021

80%

2022

1

1

2

1 ,

2

2022

2

B

OP-ADLITHO

Red K50

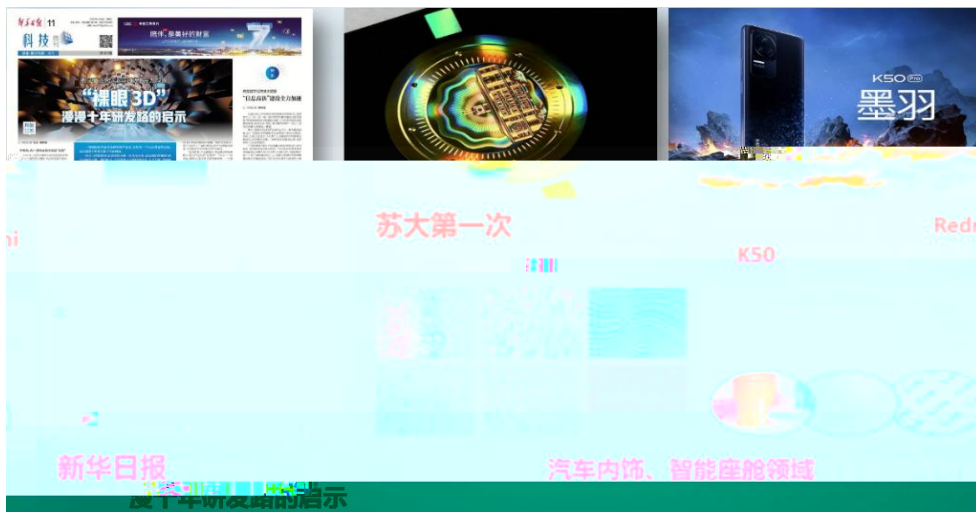
3D

3D

8

2

2018



2022

3

11

3

12

1

2

1)

2)

2022

6

4

ACS Na

A d e

R gach

3)

2022

5

3+2

2022

1

39

23



/

1

2022

2023



95%


- -

